

**PRESSEMITTEILUNG**

Wien, im Dezember 2021

**Infineon Villach: Neue Dimension in der Halbleiterproduktion****Aluminium-Fassade von Architects Collective übersetzt globale Bedeutung von Mikrochips**

Zukunft voraus: Der Technologiekonzern Infineon erweitert seine Kapazitäten am österreichischen Hauptsitz in Villach durch eine neue, vollautomatisierte Produktionsanlage zur Fertigung von Leistungshalbleitern. Die Erweiterung umfasst eine 60.000 m<sup>2</sup> große Reinraumfabrik höchster Güteklasse mit zentralem Versorgungsgebäude, Neben- und Lagergebäude, Bürogebäude, Betriebsfeuerwehr sowie die Infrastruktur für Straßenverkehr, Stromversorgung und Hochwasserschutz. Mit einer Investition von rund 1,6 Milliarden Euro schafft das Unternehmen 400 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region.

**Lebendiges Patchwork, aufgelockerte Eleganz**

Die Gestaltung der neuen Gebäude nimmt Bezug auf die Bestandsgebäude und gliedert damit die große Baumasse. Gleichzeitig verleiht sie den Neubauten einen eigenen, autarken Charakter. Um dem deutlich größeren Maßstab gegenüber dem Bestand zu entsprechen und in Anlehnung an die bestehenden Verkleidungen mit Aluminiumwellen, kommt für die Fassade der Neubauten das gleiche Material zum Einsatz.

Die besondere Ästhetik und erhabene Eleganz der Fassade der Chipfabrik übersetzt die neue Dimension der weltweit wachsenden Halbleiterproduktion für die Mikroelektronik als Schlüsseltechnologie, die inzwischen in allen Lebensbereichen von der Autoindustrie über Energieanlagen bis zu Haushalt und Spielzeug unverzichtbar geworden ist, auch in die Architektur. Die Aluminiumpaneele sind in unregelmäßigen Folgen jeweils auch um 90 Grad gedreht angebracht. Somit entsteht ein lebendiges, klares Patchwork-Muster, das die großen Volumina der Baukörper strukturiert und auflockert. Je nach Tageszeit, Sonneneinstrahlung und Witterung erzeugt das Muster Licht- und Schatteneffekte, die die Fassade beleben und ihr großzügige Eleganz und Leichtigkeit verleihen.

**Höchster Standard auch in der Architekturplanung**

Die Architekturplanung von Österreichs größtem privatem Investitionsprojekt der letzten Jahrzehnte wurde vollständig mit BIM-Technologie und im innovativen Fast-Tracking-Verfahren abgewickelt. Dabei überlappen sich Projektphasen auf flüssige Weise, was eine besondere Dynamik in die Planung bringt. Die höchstkomplexe Planungscoordination der unterschiedlichsten Gebäudetypen mit internationalen Planungspartnern erfolgte ausschließlich im virtuellen Raum und mit modernster IT-Technologie. Die High-Tech-Chipfabrik wurde nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit im August 2021 drei Monate früher als geplant in Betrieb genommen.

Dies ist die nunmehr zweite große Fertigung für 300 Millimeter-Dünnyafer – steuerbar als virtuelle und lernende Megafabrik mit Vollautomatisierung gemeinsam mit der Produktion in Dresden. Infineon schreibt mit diesem Meilenstein Baugeschichte und stärkt Europas Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit in der weltweit wachsenden Nachfrage von Leistungshalbleitern. 70.000 Kubikmeter Beton und 18.000 Tonnen Stahl wurden auf einer Fläche so groß wie 8,5 Fußballfelder verbaut.

**Für Rückfragehinweis:**

Mag. Brigitte Anna Oettl, MAS  
Architects Collective ZT-GmbH  
+43 699 142 70 555  
[brigitte.oettl@ac.co.at](mailto:brigitte.oettl@ac.co.at)



**DATENBLOCK**

<b>Projektbeschreibung</b>	Neubau einer vollautomatisierten Produktionsanlage mit Büro- und Supportgebäuden
<b>Ort</b>	Villach, AUT
<b>Bauherr</b>	Infineon Technologies Austria AG
<b>Leistungsumfang</b>	Architekturplanung Leistungsphase 2 bis 5
<b>Planungszeitraum</b>	2018 – 2019 (Entwurf und Einreichung)
<b>Bauzeit</b>	2019 – 2021 (Ausführungsplanung und Errichtung)
<b>Bruttogeschossfläche</b>	105.000 m <sup>2</sup> (BGF <sub>abz</sub> )
<b>Nutzfläche</b>	34.850 m <sup>2</sup>
<b>Investitionsvolumen</b>	€ 1,6 Milliarden (Gebäude, Reinraumtechnik, Produktionsanlagen)
<b>Architektur Einreichungsplanung</b>	Architects Collective ZT-GmbH, Wien & HWP Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart
<b>Generalplanung</b>	Clean Room Consulting, Freiburg
<b>Tragwerksplanung</b>	Boll & Partner. Beratende Ingenieure VBI Ingenieur GmbH & CO. KG
<b>Bauphysikplanung</b>	Drees & Sommer SE, Stuttgart
<b>Architektur Ausführungsplanung</b>	Architects Collective ZT-GmbH, Wien & UNIT4 GmbH & Co KG, Stuttgart
<b>Generalübernehmer</b>	Exyte GmbH, Stuttgart
<b>Tragwerksplaner</b>	HELT Ziviltechniker GmbH, Wien IBH – Tragwerksplanung GmbH, Stuttgart
<b>Bauphysikplaner</b>	Drees & Sommer SE, Stuttgart
<b>Fassadenplaner</b>	Aluminium Fassaden Consulting GmbH, Wien
<b>Brandschutzplaner</b>	Norbert Rabl Ziviltechniker GmbH, Graz



**PRESS RELEASE**

Vienna, December 2021

**Infineon Villach - a new dimension in the production of semiconductors**

Elegant Aluminium-Patchwork-Facade depicts the global impact of microchips

A leap into the future: Hi-tech company Infineon is expanding its Austrian headquarters in Villach with a new, fully automated chip factory for the production of power semiconductors. The expansion includes the 60,000 m<sup>2</sup> cleanroom factory with a central utility building, ancillary and storage buildings, offices, a fire station as well as road, flood prevention and power production infrastructure. With an investment of 1.6 billion Euros, the project will create 400 high qualified jobs in the region.

**A living and elegant patchwork**

The design of the new buildings refers to the existing structures while at the same time breaking up the very large mass of the whole and giving the extension its own individual character. In order to mirror the façade style of the existing buildings – albeit on a significantly larger scale –, corrugated aluminium panels were used.

The growing global importance of semiconductor production - an indispensable technology in all areas of life from the automotive industry to energy production, household goods and toys – is reflected in the architecture and the unique aesthetics and elegance of the façade. The façade aluminium panels were rotated 90 degrees at irregular intervals, creating a dynamic but clear patchwork pattern that visually breaks up the large volume of the various buildings. This arrangement reacts to the weather and light conditions, constantly changing the appearance of the building through a play of light and shadows.

**Highest standards of architectural planning**

Austria's largest private investment project of the last several decades makes full use of BIM and fast-track project management processes. Planning and construction phases seamlessly overlap, creating a dynamic planning environment. The planning of extremely diverse building types with international partner firms is a challenging undertaking which was achieved thanks to the latest IT technology and planning in virtual space. After planning and construction phases lasting three years, the high-tech chip factory was completed in August 2021, 3 months ahead of schedule.

The mega-factory is the second large production facility for 300 millimetre thin wafers. The production sites in Carinthia and Dresden are fully automated and jointly controllable through a virtual and learning interface. This facility marks a milestone in the construction history of Europe. It strengthens Europe's security and competitiveness in an age of growing demand for power semi-conductors. 70,000 cubic meters of concrete and 18,000 tons of steel were used in this construction, which occupies an area equivalent to 8.5 soccer fields.

**For further information please contact:**

Mag. Brigitte Anna Oettl, MAS  
Architects Collective ZT-GmbH  
+43 699 142 70 555  
[brigitte.oettl@ac.co.at](mailto:brigitte.oettl@ac.co.at)



**Data block**

<b>Project description</b>	Construction of a fully automated chip factory, offices and ancillary buildings
<b>Location</b>	Villach, AUT
<b>Client</b>	Infineon Technologies Austria AG
<b>Scope of services</b>	Strategic Definition, Concept Design, Planning Permission, Technical Design
<b>Planning</b>	2018 – 2019 (Design and Planning Application)
<b>Completion</b>	2019 – 2021 (Technical Design and Construction)
<b>Gross Floor Area</b>	105.000 m <sup>2</sup> (BGF <sub>abc</sub> )
<b>Floor Area</b>	34.850 m <sup>2</sup>
<b>Investment volume</b>	€ 1.6 Billion (Buildings, Production Facilities, Cleanroom Technology)
<b>Architecture planning application</b>	Architects Collective ZT-GmbH, Wien & HWP Planungsgesellschaft mbH, Stuttgart
<b>General planning</b>	Clean Room Consulting, Freiburg
<b>Structural engineering</b>	Boll & Partner. Beratende Ingenieure VBI Ingenieur GmbH & CO. KG
<b>Building physics planning</b>	Drees & Sommer SE, Stuttgart
<b>Architecture spatial coordination and technical design</b>	Architects Collective ZT-GmbH, Vienna & UNIT4 GmbH & Co KG, Stuttgart
<b>General contractor</b>	Exyte GmbH, Stuttgart
<b>Structural engineering</b>	HELT Ziviltechniker GmbH, Wien
<b>Building physics planning</b>	IBH – Tragwerksplanung GmbH, Stuttgart
<b>Façade planning</b>	Drees & Sommer SE, Stuttgart
<b>Fire safety planning</b>	Aluminium Fassaden Consulting GmbH, Wien Norbert Rabl Ziviltechniker GmbH, Graz